# 一种基于同轴谐振腔技术的非金属缺陷测量方法

徐 宇<sup>1</sup> 杨晓庆<sup>1</sup> 尚劲松<sup>1</sup> XU Yu YANG Xiaoqing SHANG Jinsong

# 摘要

随着航空航天领域对非金属复合材料构件质量要求的不断提升,准确检测其内部缺陷对保障飞行安全与设备可靠性意义重大。为解决现有检测方法在分辨率和灵敏度上的不足,文章设计了一种新型的微波同轴谐振腔传感器,用于测量非金属缺陷,该复合材料广泛应用于航空航天。根据近场微波测试原理搭建了一套近场微波扫描系统,提出一种基于谐振频率偏移的提离距离测试方法,通过电磁仿真软件建模、实验加工与测试,对  $\lambda/4$  同轴谐振腔进行了综合研究。采用 S 参数测量技术,对谐振腔的振频点 S11 幅值及频率进行了精确测量,从而获得了覆盖非金属薄膜的裂纹缺陷的微波扫描图像,实现了 0.01  $\lambda$  的超分辨率成像效果。

关键词

亚表面缺陷; 非金属缺陷; 超分辨率成像; 近场微波扫描系统; 微波同轴谐振传感器

doi: 10.3969/j.issn.1672-9528.2025.04.046

#### 0 引言

随着科学技术的飞速发展和工业生产的更新迭代, 材料 已然成为国家基础建设、国防建设和人民生产生活中不可或 缺的一部分。同时,材料科学的研究也随之不断发展,相继 发现高分子材料、有机材料和非金属复合材料等多种新型材 料。其中, 非金属复合材料是一种通过物理或者化学的加工 方式,将多种具有不同性质的非金属材料在宏观上组合而成 具有新性能的材料[1]。例如碳纤维、玻璃纤维和合成陶瓷均 属于非金属复合材料的范畴。相比传统材料来讲,非金属复 合材料在克服单一材料某些特性不足的同时, 能够更好地利 用材料各自的优势, 达到更优性能。因其具有高强度、高刚 度、重量轻、弹性优等特点,被广泛用于油井管道、航空航天、 汽车制造等领域中替代金属构件[2]。然而,非金属复合材料 在成型过程和长期使用过程中,由于加工工艺、极端环境、 疲劳累积、撞击等物理化学因素的影响,材料内部容易产生 空洞、分层等缺陷。如果非金属复合材料构件中存在的缺陷 不能被及时发现并处理, 在未来的使用过程中, 这些无法被 直接观察到的缺陷将会影响复合材料的性能和强度,带来安 全隐患和难以预料的损失[3-4]。想要避免由于存在缺陷而带来 的潜在安全隐患, 就必须在材料制造和使用过程中进行严格 的监测和评估,及时发现已经出现的缺陷或者提前预测可能 出现的危害,这对保障系统的安全尤为重要。

一些检测技术已被研究并用于复合材料的缺陷检测,例

如超声波检测、X 射线和红外热成像技术 [5-8]。尽管这些方法在当前应用中具有一些优点,但仍存在一些局限性。例如,超声波检测需要偶联剂,这会破坏被测材料的形状(MUT); X 射线对人体有害,设备昂贵;热成像技术需要大量时间,导致检测速度慢。与上述方法相比,微波无损检测具有设备简单、操作方便、无需耦合剂、非接触式测量等特点,在无损检测领域发挥着重要作用。波导 [9] 和平面谐振传感器 [10] 主要研究用于非金属复合材料的检测,通过测量其反射系数或透射系数的偏移来判断缺陷。然而,它们的电磁场(EM)并不集中,因此主要用于检测较大尺寸的缺陷。为检测较小尺寸的缺陷,需要以更高的频率工作以获得更高的灵敏度,这增加了测试成本。通过设计微波近场传感器解决了这一限制。

微波近场显微镜是在微波频段利用近场探针与样品之间 发生的相互作用,进而影响谐振腔的谐振频率与品质因数等 微波参数,反演出样品的电磁信息。微波近场显微镜利用倏 逝波突破了衍射极限,使分辨率提升至微米甚至纳米。1928 年,Synge<sup>[11]</sup> 首次提出近场微波显微镜的概念,后来人们利 用同轴谐振腔高品质因数的特点搭建了具有很高分辨率的测 试系统<sup>[12-13]</sup>,利用近场微波显微镜,开展了铁电材料测试以 及无损检测等研究<sup>[14-15]</sup>。

本文采用带有钨钢探针的 λ/4 波长的同轴谐振腔的 NSMM 系统,以其微波能量在探针机场区域具有高灵敏度和空间分辨率的特点,利用带缺陷的非金属薄膜样品在探针场聚焦区域引起的电磁围绕,无损高效地表征 100 μm 薄膜下的裂纹缺陷,这种方法对于航空航天的非金属材料下缺陷检

<sup>1.</sup> 四川大学 四川成都 610021

测有重大意义。

#### 1 NSMM 结构和工作原理

图 1 为本文设计的 λ/4 同轴谐振腔,是 NSMM 系统的核心组成部分。微波能量由矢量网络分析仪发出,从其中一端口输入,激励谐振腔的谐振;另一端口为输出由矢量网络分析仪接收。当外界样品处于微波同轴探针的作用范围时,腔体的传输系数发生改变,可通过此变化实现对样品结构信息的反演。该设计采用了一种由外导体、内导体、SMA 接头以及电耦合探针构成的 λ/4 同轴谐振腔。在此结构中,内导体的长度被精确设定为腔体谐振频率对应的波长 λ 的四分之一。



图 1 λ/4 同轴谐振腔实物图

具体而言,本文所设计的微波同轴谐振传感器工作在 1.818 2 GHz的谐振频率,据此推导得出其内导体长度。此外, 该谐振腔的其他尺寸参数如表 1 所示。

表 1 同轴谐振传感器理论评估结构参数

谐振腔结构	参数 /mm	类别	参数 /mm
腔体内半径	5	馈电端口半径	4.10
腔体高度	40	耦合探针半径	0.2
腔体长度	50	耦合探针长度	16
腔体内导体高度	28	探针半径	0.2
腔体尖锥高度	1.50	探针孔半径	0.5

前端探测的探针的作用是随谐振腔内电磁场变化产生隐 失场作用于待测样品。隐失场的电场强度随着探针与物品的 距离增大而迅速衰减,当距离过大时将导致样品结构信息无 法扰动腔内电场,所以需要寻找探针与待测样品间的最佳提 离距离。

基于仿真模型,本文实现了 λ/4 同轴谐振腔的精密加工。 该微波同轴谐振传感器包括电容加载的同轴谐振腔、探针、 电偶和探针以及 SMA 转接头。为增强针尖处的隐失场强度, 对同轴谐振腔内导体的底部采用针尖直径约为 50 μm 的钨钢 探针。

通过对图 2 的细致观察与分析,可以观察到所加工的  $\lambda/4$  同轴谐振腔在谐振频率方面展现出高度的一致性,其相 对误差维持在 0.07 GHz 以下。同时, S21 幅值的测量数据

与预期结果基本一致,尽管存在一定偏差,但该偏差可能归因于多个潜在的因素,包括但不限于加工过程中的精度限制、SMA转接头的性能波动,以及材料特性本身的不确定性。这些因素均有可能对谐振频率和 S21 幅值的测量精度产生不利影响。

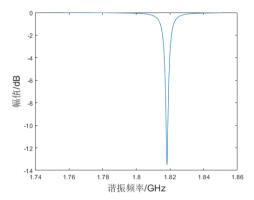


图 2 λ/4 同轴谐振腔实测 S 参数曲线

#### 2 NSMM 探测系统组成及设置

微波近场探测系统由多个关键组件构成,主要包括 λ/4 同轴谐振腔、金属探针、矢量网络分析仪、三维步进电机位移台、CCD 光学相机、光源以及一台由上位机软件控制的计算机。为确保实验的稳定性与精确性,除计算机与矢量网络分析仪外,所有其他组件均安装于抗震性能卓越的大理石平台上。图 3 详细展示了微波近场显微镜测试系统的实体配置。

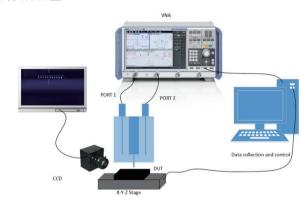


图 3 NSMM 系统图

在一侧安装的 CCD 相机与一组可变焦镜头组合,构成了一套高精度放大镜系统,该系统通过连接至液晶显示器(LCD)作为监视器,用于实时监控针尖相对于样品的位置关系。热光源确保了对针尖与样品相互作用区域的有效照明,从而提升了 CCD 放大镜在 LCD 上显示探针尖端的清晰度。此外,一台计算机通过接口与三维步进电机位移台相连,采用 C#编程环境实现对位移系统的精确控制,并同步从矢量网络分析仪(VNA)收集数据,将数据记录于文件中,方便后续计算或成像分析使用。

在传统矢量网络分析仪(VNA)的接收器架构中,普遍采用基于调谐接收机的设计原理。该设计通过本振器(LO)将接收到的微波信号进行混频处理,从而将其转换至较低的中频(IF)信号。经过带通滤波器处理后的中频信号,能够有效缩小接收机的带宽,从而显著提升系统的灵敏度、动态范围及测量精度。通过减小中频带宽(IFBW),可以有效地降低系统本底噪声,进而提高 VNA 的测量精度。然而,较低的 IFBW 将导致采集时间的延长,从而增加整体的检测周期。相反,较高的 IFBW 虽然可以缩短采集时间,但会牺牲测量精度,影响检测结果的准确性。因此,合理选择 IFBW 的设定值对于确保整个系统能够高效且精确地进行检测至关重要。本文选取的 IFBW 为 3 kHz。

#### 3 微波近场检测结果分析

在近场扫描微波显微术(NSMM)中,微波谐振腔设计用于将隐失场集中于探针尖端。当探针尖端与样品之间的距离处于隐失场区域内,探针尖端的高场强会辐射到样品表面,同时样品探针尖端与样品之间的相互作用,对谐振腔产生微扰。该相互作用不仅受样品电磁特性的影响,而且探针与样品间的间距亦为关键影响因素。为消除探针与样品间距对测试结果的影响,本文采纳软接触模式进行样品测量。软接触模式定义为探针尖端与样品之间的临界接触状态,即接触距离 H=0。研究者通常利用 CCD 相机监控探针与样品间的距离,以实现软接触。然而,在实际操作中,由于人眼观测误差及滑台控制不准确,软接触的实现面临挑战。针对此问题,本文提出了一种最小化探针损害的软接触方法。

准静态模型揭示了谐振腔谐振频率 f, 与提离距离 H 以及样品介电常数  $\varepsilon$ , 之间的定量关系,具体表现为:

$$\frac{f_r - f_0}{f_r} = -A(\frac{\ln(1-b)}{b} + 1) \tag{1}$$

$$b = (\varepsilon_r - 1)/(\varepsilon_r + 1) \tag{2}$$

式中: f, 为谐振腔的谐振频率; f<sub>0</sub> 为谐振腔的空载谐振频率; A 为一个与谐振腔的腔体结构及波长有关的常数;  $\varepsilon$ <sub>r</sub> 为介质的相对介电常数。

根据准静态模型理论的推导,针尖与样品的间隙 H缩小时,谐振频率 f, 变化速率显著增加。设任意一个测试点 a<sub>n</sub> 的谐振频率为  $f(a_n)$ ,相邻两个点之间的谐振频率差值  $\Delta f_r = f(a_n)$ - $f(a_{n-1})$ 。在实际检测过程中,由于待测物品表面可能存在不规则性,探针针尖需与待测物保持一定距离,以避免对探针造成损坏;同时,若探针针尖与待测物距离过远,同轴谐振腔通过探针辐射的能量将无法有效作用于待测物,从而影响谐振频率的变化。

为规避上述两种不利情形,本文设定谐振频率变化阈值

Δf,为500 kHz。在实验操作中,通过控制三维步进电机位移台,使探针从待测物正上方约500 μm 处开始,以10 μm 的步进逐渐向下移动。当监测到的谐振频率变化超过500 kHz 时,即可认为实现了软接触状态。具体提离距离确定曲线如图4 所示。

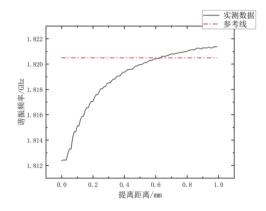


图 4 谐振频率随提离变化关系

为实现探针针尖与待测样品之间的软接触模式,本研究采纳了上述判定准则。随后,设定三维步进电机位移台沿x轴的移动范围介于  $0\sim7$  mm 之间,并规定扫描间隔为  $10~\mu$ m。所选待测样品为  $100~\mu$ m 厚的非金属薄膜,该薄膜沉积在带有三道划痕的金属基底上,每道划痕的宽度  $100~\mu$ m,且相邻划痕之间的距离相差  $1~\mu$ m。扫描方向如图  $5~\mu$ 所示。

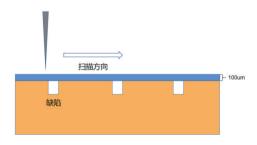


图 5 非金属薄膜下金属缺陷检测示意图

扫描结果如图 6 所示,可以看出在 2~5 mm 范围内有 3 处谐振频率发生明显变化,位置分别为 2.42 mm、3.4 mm、4.32 mm,检测结果与实际相符。

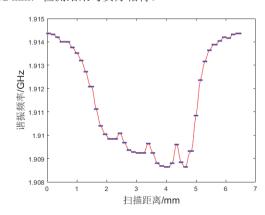


图 6 非金属薄膜下金属缺陷检测示意图

整体扫描结果如图 7 所示。

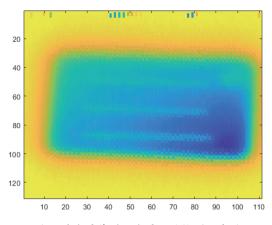


图 7 非金属薄膜下金属缺陷检测示意图

在实际应用中,表面非金属薄膜可以为非透明,实现了 不透明物体内部隐藏结构的无损透视探测,是光学显微镜所 观测不到的。

## 4 结语

本文提出了一种新型的微波同轴传感器,旨在实现对非金属基材内部缺陷的高灵敏度检测。该传感器的设计独具匠心,有效提升了缺陷检测的敏感度。通过电磁场的仿真分析,证实了当传感器探针遭遇非金属基材内缺陷时,其谐振频率将出现上升的趋势。此外,还构建了一套基于矢量网络分析仪(VNA)与计算机的微波近场扫描测量系统(NSMM),展示了该系统在航空航天领域测量应用中的巨大潜力。综上所述,凭借其高分辨率成像与测量能力,NSMM 技术在缺陷检测与成像领域已呈现出广泛的应用前景。

#### 参考文献:

- [1] 张彭涛,碳纤维复合材料分层损伤的超声波无损检测研究 [D], 哈尔滨:东北林业大学,2006.
- [2] 刘莹,孙璐.先进复合材料在航空航天的现状与应用 [C]// 中国空间技术研究院.第三届空间材料及其应用技术学术 交流会论文集.北京:北京卫星制造厂宇航材料与制造技 术试验检测中心,2011:72-76.
- [3] 王秋霞.世界复合材料强国与我国的复合材料现状及发展动向[J].玻璃钢/复合材料,1999(1):40-44.
- [4] 嘉文,周华丽.教育区块链[M].北京:机械工业出版社, 2021.
- [5] 张贺斌.超声检测技术在复合材料构件上的应用研究 [D]. 武汉:武汉理工大学,2011.
- [6] 刘怀喜,张恒,闰耀辰.声发射技术在复合材料中的应用及研究进展[J].纤维复合材料,2002(4):50-52.

- [7] 张晓燕,金万平.红外热波检测技术在美军装备维修中的 应用 [J]. 航空维修与工程,2006(5):41-43.
- [8] 罗盼. 基于 X 射线图像焊缝缺陷检测系统关键技术研究 [D]. 重庆: 重庆邮电大学, 2020.
- [9] 张蒙蒙. 基于微波成像的非金属管道无损检测方法研究 [D]. 西安: 西安石油大学, 2023.
- [10] ZHANG J, HU W L, CHEN Z B, et al. Reliable crack monitoring based on guided wave through periodically loaded transmission line[J].IEEE sensors journal, 2023 23(7):6799-6809.
- [11] SYNGE E H. XXXVI. A suggested method for exten ding microscopic resolution into the ultra-microscopic region[J]. The london, edinburgh, and dublin philosophical magazine and journal of science, 1928,6(35):356-362.
- [12] ANLAGE S M, TALANOV V V, SCHWARTZ A R. Principles of near-field microwave microscopy[J]. Scanning probe microscopy, 2007:215-253.
- [13] IMTIAZ A, WALLIS T M, KABOS P. Near-field scanning microwave microscopy:an emerging research tool for nanoscale metrology[J]. IEEE microwave magazine, 2014, 15(1): 52-64.
- [14] BIAGI M C, FABREGAS R, GRAMSE G, et al. Nanoscale electric permittivity of single bacterial cells at gigahertz frequencies by scanning microwave microscopy[J]. Acs nano, 2015, 10(1):280-288.
- [15] FARINA M,DONATO A D, MONTI T, et al. Tomographic effects of near-field microwave microscopy in the in vestigation ofmuscle cells interacting with multi walled carbon nanotubes[J]. Applied physics letters, 2012, 101(20): 203101.

### 【作者简介】

徐宇(1999—), 男, 四川攀枝花人, 硕士, 研究方向: 微波传感器设计、微波无损检测。

杨晓庆(1978—), 男,四川成都人,博士,教授,研究方向: 电磁超材料、微波无损检测和多物理场分析。

尚劲松(2001—), 男, 山东泰安人, 硕士, 研究方向: 微波传感器设计、微波无损检测、深度学习。

(收稿日期: 2024-12-12)